Sicherheitshinweise

Metallstaub ist gesundheitsschädlich. Beim Ausarbeiten Absaugung benutzen. Allergien gegen Bestandteile der Legierung oder elektrochemisch bedingte Missempfindungen sind in seltenen Einzelfällen möglich.

Wechselwirkungen

Bei okklusalem und approximalem Kontakt unterschiedlicher Legierungen sind in seltenen Einzelfällen elektrochemisch bedingte Missempfindungen möglich.

Gewährleistung

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, ganz gleich ob sie mündlich, schriftlich oder im Wege praktischer Anleitung erteilt werden, beruhen auf unseren eigenen Erfahrungen und Versuchen und können daher nur als Richtwerte gesehen werden. Die Legierungen von C.HAFNER sind für den Einmalgebrauch ausgewiesen. Bitte trocken und bei Raumtemperatur lagern.

C.HAFNER
Edelmetall · Technologie

C.HAFNER GmbH + Co. KG
Gold- und Silberscheideanstalt
Maybachstrasse 4
71299 Wimsheim
Tel. +49 7044 90333-333
dental@c-hafner.de
www.c-hafner.de

D 5.2024. © C.HAFNER, D-Wimsheim.

Orplid® TK

Hochgoldhaltige Gusslegierung nach DIN EN ISO 22674 zur Herstellung von Zahnersatz

Indikationen: Inlays, Kronen, Brücken aller Spannweiten, Verblendung mit Kunststoff

Farbe: Gelb

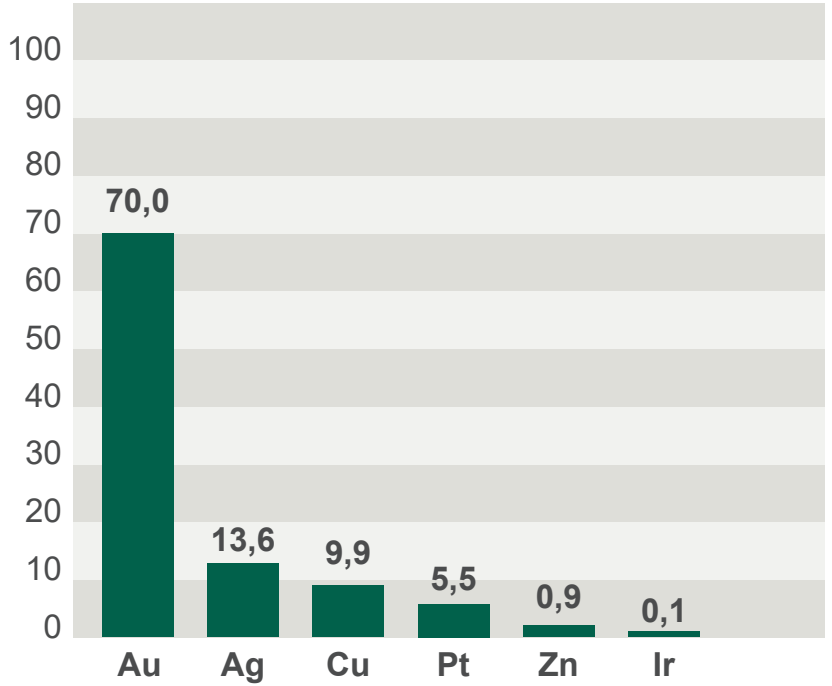
Typ: 4

REF 1574

MD

CE 0483

Legierungszusammensetzung %



C. HAFNER GmbH + Co. KG
Gold- und Silberscheideanstalt
Maybachstrasse 4 · 71299 Wimsheim · Deutschland

Technische Daten Orplid® TK

Dichte (g/cm³)	15,4
Schmelzintervall °C	925-895
Härte (HV 5/30) w,a,g/b	190, 255, 250
Vorwärmtemperatur °C	700
Gießtemperatur °C	1055
Weitererhitzen nach dem Aufschmelzen (s) elektrisch 15-20, induktiv 5-8, Flamme 5-8	
0,2% Dehngrenze (MPa) w, a, g/b	375, 620, 645
Bruchdehnung (%) w, a, g/b	35, 15, 10
E-Modul (GPa)	98
Flußmittel:	z.B. Pasta Flux
WAK 25-500 (600) °C	- µm/mK
Lotempfehlung:	Orplid® Lote 825, 790
Laserschweißdraht:	Orplid® TK 0,35 mm
Weichglühen: 750 °C / 15 min, in Wasser abschrecken Aushärten: 450 °C / 15 min	

w = weich, a = ausgehärtet, g/b = nach dem Guß bzw. Brand

Gebrauchsanweisung

Anstiften:

nach zahntechnischen Regeln (siehe Allgemeine Gebrauchsanweisung)

Einbetten:

phosphatgebundene Einbettmassen

Vorwärmen:

700 °C, 30-120 min. auf Endtemperatur, je nach Muffelgröße

Gießen:

1055 °C, bei Vakuum-Druckguss widerstandsbeheizt um 20-30 °C erhöhen, Graphittiegel bzw. bei offener Flamme mit Keramiktiegel

Ausarbeiten:

mit Hartmetallfräsen und/oder keramisch gebundenen Steinen

Reinigen:

Ultraschallreinigung oder abdampfen mit Dampfstrahlgerät